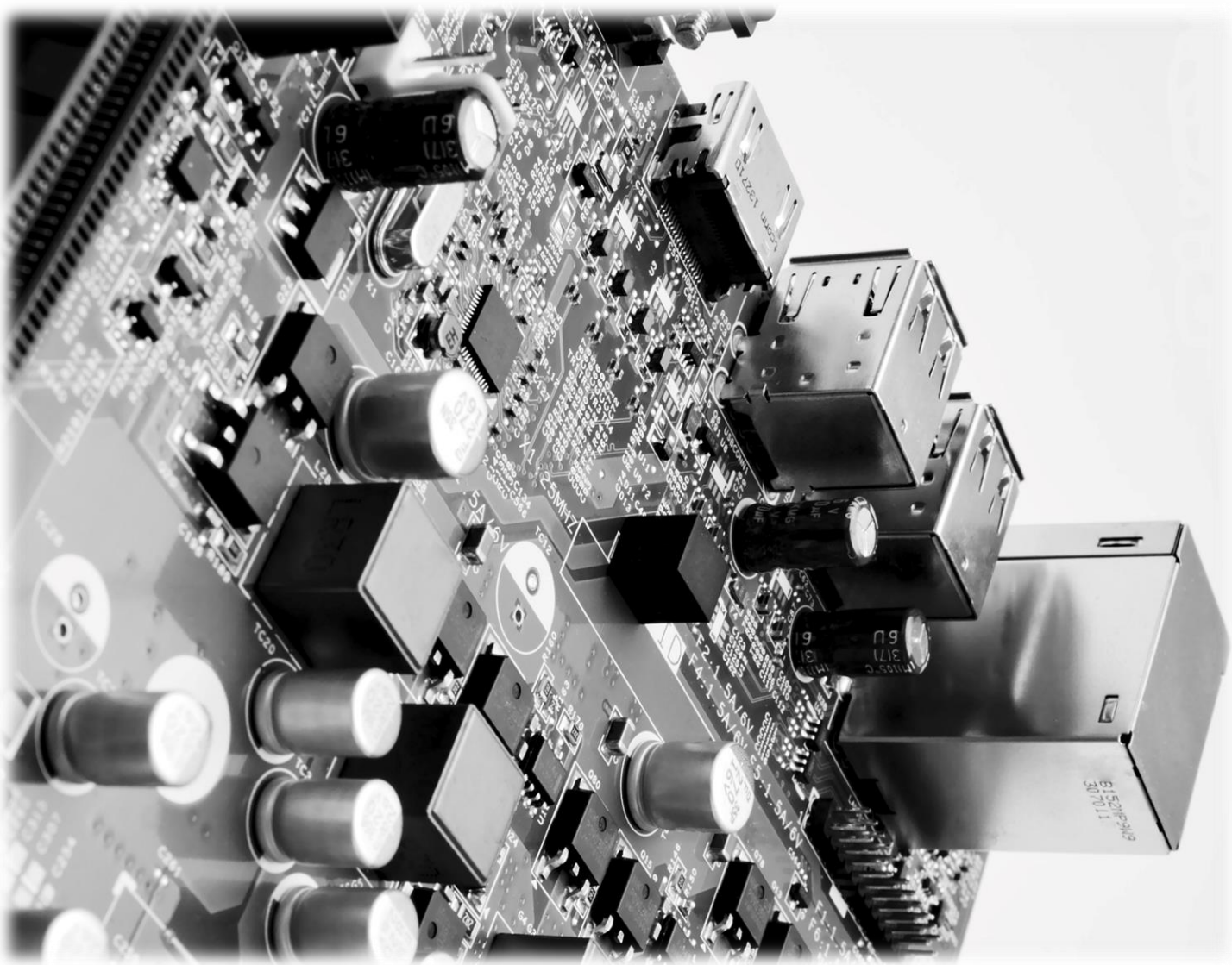




联系我们：

张 艳：138-5168-3378，3812623191@qq.com

荣 岩：180-6607-5325，3412741369@qq.com

田晓冰：152-5095-2541，2680847316@qq.com

许飞艳：132-7663-5250，1781182189@qq.com

杨慧子：159-9624-3638，3599640064@qq.com

固话（传真）：025-6986-2064

网址：<http://www.chipsmate.com/>

地址：

南京市江宁区汤山街道天润路800号11栋-2号楼

深圳市南山区高新南九道45号西工大三航科技大厦20楼

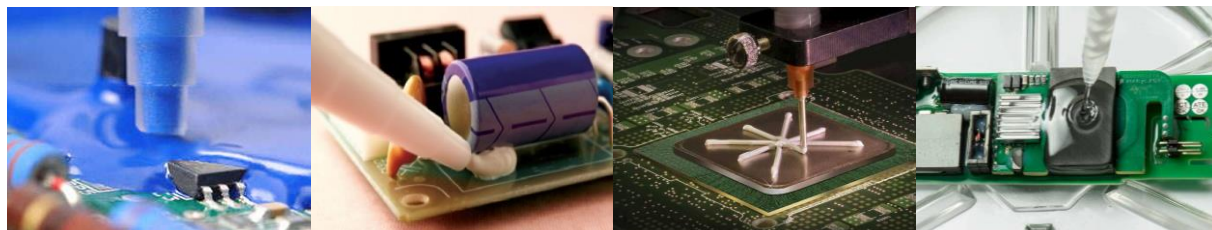


企业简介

- 成都坤宣智能科技有限责任公司，成立于2019年，作为专业专注于军工电子产业的有机聚合物胶粘剂供应商，是集科技研发、精益制造、品牌营销于一体的四川省高新技术企业。在新兴和传统工业领域积累了丰富的开发与应用经验，形成了以有机硅、环氧树脂为基准的完整产品技术体系。可以提供全方位多系列的产品线的应用，密封胶、灌封浇注料，结构粘接剂、三防涂料、高性能导热界面材料等产品，普遍应用于主流军工研发生产单位如雷达、无人机、制导系统、船舶等。

主要产品与应用

- 主要产品为有机硅、环氧、聚氨酯电子组装类胶粘剂材料。



- 混合集成电路用胶
- 分立器件用胶
- 微波类电路用胶
- 阻容感类用胶
- 连接器用胶
- 组件类结构装配用胶

客户数量80+

配方数量120+

应用案例500+

合作伙伴



资质认证

- GJB 9001C-2017质量管理体系
- ISO 9001产品质量管理体系
- ISO 14001环境质量管理体系
- IATF 16949汽车行业产品质量管理体系
- UL认证
- ROHS指令认证

研发能力

企业获得16个新型应用专利和发明专利，拥有专业的1600平米的针对新品开发应用基地。研发方面，科研人员共10人其中博士3人，硕士7人，并配备先进的物理与化学实验室，可模拟用户使用环境进行各式电学、热学、力学与环境试验。并且和国内顶尖胶粘剂研究机构四川大学与电子类研究龙头电子科技大学有深入合作，掌握从机理研究到应用验证的全流程产品开发能力。



定制化配方/工艺服务

当前国家对基础材料研究高度重视，并且面对进口关键胶粘材料随时断供的风险，辅料100%国产化已经成为基本要求，进而保障军品需求的安全性。并且国外产品多为工业级，不仅无法满足GJB548B方法5011的要求，而且技术服务不佳无法适应个性化研发。坤宣可提供针对国产化替代的特色需求，进行一对一服务，深入到用户工艺开发的各个环节，进行定制化配方/工艺服务。



- 个性化开发
- 满足军品应用条件
- 深度国产化保障杜绝伪国产化

自动化工艺解决方案

面对进口胶粘剂的应用环节，坤宣可以提供现场工程师驻场服务针对产品特性与用户需要，规范产品使用工艺，提高最终产品质量可靠性，规避工艺风险。并且鉴于电子工业的发展，提供胶粘剂应用中施胶、固化与贮存的各个场景的自动化国产解决方案。打通进口胶粘材料的常见堵点，真正协助提升用户的生产效率与成本控制。



- 现场工程师，现场服务
- 各类胶粘剂的使用自动化设备



典型案例分析-灌封/粘接/涂覆

模块类胶粘剂国产化原位替代方案

- 板级电子装联用胶
- 芯片级电子封装用胶
- 种类齐全满足完整的产品需求



1.固定胶-电子元器件的批覆、
粘接、密封
有机硅密封胶
环氧粘接胶

替代道康宁RTV3140
替代道康宁RTV3145
替代道康宁7091
替代环氧公司H54
替代乐泰3609



2.导热胶-大功率电器模块与
散热器之间的导热及散热
有机硅导热胶

替代道康宁SE4420
替代道康宁SE4450
替代道康宁SE4485



3.敷型涂料-对线路板起防潮
防尘绝缘防震的作用

替代道康宁1-2577
替代道康宁RTV3140



4.导电银胶-微电子装配导电
粘接

替代6144
替代84-1
替代H9480



5.电磁屏蔽-电子设备间的干
扰，室温固化操作便捷

替代环氧公司H20E
替代派克584-0029



- 产品均拥有军品实际应用
- 原位替代且关键参数更优

- 满足国军标质量要求
- 系列化产品匹配不同需求



6.导热硅脂/凝胶-低应力柔软的高导热 (1.0w-7.0w) 材料
硅凝胶
导热硅脂

替代固美丽GEL-30
替代博恩TG350-6
替代道康宁CN8880



7.贴片胶-芯片粘接
绝缘贴片胶
导电贴片胶

替代乐泰84-3
替代环氧公司H70E
替代乐泰84-1
替代环氧公司H20E/H37MP
替代京瓷CT285



8.灌封胶-散热要求高的器件, 起导热阻燃、防潮绝缘防震的作用
有机硅导热灌封胶
环氧导热灌封胶
特种高温灌封胶

替代洛德SC324
替代洛德SC-320/SC-320LVH
替代洛德SC-315/SC-309
替代洛德6702
替代道康宁DC160/170/8760
替代乐泰EC104
替代环氧公司353N



9.高温环氧胶-用于高温结构粘接及灌封要求, 耐温范围: -55°C~500°C

替代乐泰EC104



10.芯片固定胶-用于可拆卸BGA, 黑色固定胶

替代UA20505B

质量优势

- 产品原位替代且关键参数更优；
- 产品满足国军标GJB548B方法5011与航天真空出气要求；
- 系列化产品更匹配不同需求，避免使用风险；
- 产品均拥有军品实际应用如电科43所、24所、9所，中船716所，699厂，成都715厂，成都宏科，黄河机器、中电083基地、航天科工2院、3院、航天长峰、航天科技8院、722所等单位；
- 配有先进的粘度计、流变仪、导热仪、电子万能试验机等检验设备满足100%的出厂合格率



交期优势

- 500kg以下产品，生产周期均小于2周；
- 重要原材料均实现长期备料库存；
- 常规产品拥有现货，可实现配合生产节拍的滚动交付；
- 所有原材料均为100%国产，杜绝伪国产



服务优势

- 满足多品种小批量的供应要求，可实现特殊情况下的紧急交付；
- 提供现场工艺服务；
- 完备的售后体系，可实现7×24H服务；
- 个性化需求研发，定制化/半定制化服务



物流优势

- 可根据需要提供不同类型的包装；
- 及时交付，可进行一对一送货上门；
- 需要冷藏的产品提供冷链物流，避免质量风险



国产化替代拳头产品及自研产品列表

索引	对标型号	国产型号	主要用途	特点
■ 导热灌封胶				
A1	洛德 SC-320	KXS320-3.5	电源模块	高导热
A2	洛德 SC-320lvh	KXS320-2.6	电源模块	导热/流动
A3	道康宁 DC-160	KXS160	电源模块	流平性
A4	坤宣	KXS6410	电路模块	高强度/环氧型
A5	道康宁 7091	KXS7091	电源模块	单组份/粘接
■ 导电银胶				
B1	乐泰 84-1	KXS84-1	微组装	导电粘接
B2	EPO H20E/H37	KXS20E	微组装	导电粘接
B3	洛德 6144	KXS6144	钽电容	导电粘接
B4	NAMICS H9480	KXS9480	钽电容	高导电
B5	派克 584-0029	KXS5840029	电磁屏蔽	常温固化
B6	乐泰 JM7000	KXS7000	芯片组装	耐高温 (250℃) /特殊材料粘接
■ 高温环氧胶				
C1	EPO H54/WK8017D	KX-380/KXS54	磁芯粘接	低应力/耐高温
C2	乐泰 EC104	KXS6593	连接器粘接	耐高温/耐冲击
C3	Zymet UA2605	KXS2605/KXS2605B	BGA邦定	低膨胀/返修性
C4	NAMICS U8410-99	KXS8410-90	芯片底部填充	抗冲击/低膨胀
C5	乐泰 3609系列	KXS3609系列	SMT贴片红胶	单组份/工艺性好
■ 硅橡胶				
D1	道康宁 3040RTV	KXS3040	器件固定/涂敷防护	室温固化/操作方便
D2	道康宁 3140RTV	KX-3140	器件固定/涂敷防护	空间级
D3	道康宁 3145RTV	KX-3145	器件固定/涂敷防护	触变性
D4	道康宁 SE4420/4450	KX-4420/4450	芯片贴装	导热粘接
D5	WK-612	KXS612	IGBT灌封	硅凝胶/低应力
D6	WK-920LT	KXS920LT	电路板/高压电源	透明/低应力
■ 三防涂料				
E1	道康宁 DC1-2577	KXS1-2577	印制电路板	低应力/低透气率/介质损耗低
E2	易力高 CRC70	KXS200A	结构件/印制板/线缆	有机硅改性/现场自喷罐
E3	HUMISEAL 1B31	KXS1B31	结构件/印制板/线缆	丙烯酸/硬度高/外观好
■ 厌氧螺纹锁固胶				
F1	乐泰290/270/222	KXS290/270/222	螺纹锁固	丙烯酸厌氧/工艺性好
■ 聚氨酯粘接密封胶				
G1	UR 1087	KXS1087	聚酯纤维织布粘接	高强度/耐候性好
■ 聚氨酯发泡胶				
H1	坤宣	KXS1025	电路板灌封减震	高强度/抗震性好/可操作时间长
■ 单组份导热凝胶				
I1	坤宣	KXS800	芯片散热	工艺性好/高导热
■ 导热硅脂				
J1	信越/道康宁	KXS0007系列	芯片散热	高导热
■ 低温特种胶				
K1	坤宣	KXS90	超低温环境粘接	耐超低温 (-90℃)
K2	坤宣	KXS-ST	超低温环境粘接	耐超低温 (-150℃~+300℃)



导热灌封胶 KXS320-3.5

产品简介

- KXS320-3.5 是一款双组份加成型有机硅导热灌封胶。该产品与同类进口产品相比较粘度更低，流动性更好，自流平消耗性好，可操作时间较长，使用简单方便；其固化物具有优异的导热性，阻燃性，可在-60℃~220℃范围内长期使用；能够对电子元器件及模组起到良好的密封、绝缘保护及散热作用。

产品特点

- 高导热，可室温或加温固化；低硬度，低应力；阻燃-完全符合UL94-V-0认证；耐高低温，可耐受-60℃~220℃；抗沉降性能好。

典型性能

固化前性能	测试项目	参考标准	单位	数值	
	外观	目测	/	A组份	粉红色流体
				B组份	白色流体
	粘度	ASTM D2196	cps	A组份	8500
				B组份	8500
	密度	ASTM D792	g/m³	A组份	3.05±0.05
B组份				3.05±0.05	
混合后性能	配比（重量比或体积比）		/	1： 1	
	混合后粘度	ASTM D2196	cps	8500	
	可操作时间	SLQB-01	min	90-120	
	初固时间	SLQB-02	h	7-9	
	固化时间	SLQB-03	h	@25℃	24
			min	@80℃	30-40
固化后性能	外观	/	/	浅粉红色固体	
	硬度	ASTM D2240	Shore-A	≥50	
	密度	ASTM D792	g/m³	3.0±0.05	
	导热系数	ASTM D5470	W/m.k	≥3.5	
	线性热膨胀系数	ASTM C864	ppm/℃	112	
	介电强度	ASTM D149	KV/mm	≥18	
	体积电阻率	ASTM D257	Ω.cm	> 1*10 ¹⁴	
	阻燃等级	UL-94	/	V0	





产品简介

- KXS320-2.6是一款双组份加成型有机硅导热灌封胶。该产品与同类进口产品相比较粘度更低，流动性更好，自流平消耗性好，可操作时间较长，使用简单方便；其固化物具有优异的导热性，阻燃性，可在-60℃~220℃范围内长期使用；能够对电子元器件及模组起到良好的密封、绝缘保护及散热作用。

产品特点

- 高导热，可室温或加温固化；低硬度，低应力；阻燃-完全符合UL94-V-0认证；耐高低温，可耐受-60℃~220℃；抗沉降性能好。

典型性能

固化前性能	测试项目	参考标准	单位	数值	
	外观	目测	/	A组份	粉红色流体
				B组份	白色流体
	粘度	ASTM D2196	cps	A组份	4800
				B组份	4800
	密度	ASTM D792	g/m³	A组份	2.95±0.05
				B组份	2.95±0.05
混合后性能	配比（重量比或体积比）		/	1： 1	
	混合后粘度	ASTM D2196	cps	4800	
	可操作时间	SLQB-01	min	60-120	
	初固时间	SLQB-02	h	7-9	
	固化时间	SLQB-03	h	@25℃	24
			min	@80℃	30-40
固化后性能	外观	/	/	浅粉红色固体	
	硬度	ASTM D2240	Shore-A	≥50	
	密度	ASTM D792	g/m³	2.95±0.05	
	导热系数	ASTM D5470	W/m.k	≥2.7	
	线性热膨胀系数	ASTM C864	ppm/℃	112	
	介电强度	ASTM D149	KV/mm	≥18	
	体积电阻率	ASTM D257	Ω.cm	> 1*10 ¹⁴	
	阻燃等级	UL-94	/	V0	





双组份导热灌封胶 KXS160

产品简介

- KXS160 是一款双组份加成型有机硅导热灌封胶。该产品粘度低，流动性好，使用简单方便；其固化物具有优异的导热性，电气性能，可在-60℃~220℃范围内长期使用；能够对电子元器件及模组起到良好的密封、绝缘保护及散热作用。

产品特点

- 较低粘度，优异的流平性；优异的电气性能。
- 可室温或加温固化，耐高低温，可耐受-60~220℃；420℃，30min。
- 抗沉降性能好。

典型性能

固化前性能	测试项目	参考标准	单位	数值	
	外观	目测	/	A组份	黑色液体
				B组份	白色液体
	粘度	ASTM D2196	cps	A组份	2500 ~ 5000
				B组份	2000 ~ 4000
	密度	ASTM D792	g/m³	A组份	1.65±0.05
				B组份	1.65±0.05
混合后性能	配比（重量比或体积比）		/	1： 1	
	混合后粘度	ASTM D2196	cps	2000 ~ 4500	
	可操作时间	SLQB-01	min	60-120	
	初固时间	SLQB-02	h	4-6	
	固化时间	SLQB-03	h	@25℃	24
			min	@80℃	30
	固化后性能	外观	/	/	灰色固体
硬度		ASTM D2240	Shore-A	≥45	
密度		ASTM D792	g/m³	1.83±0.05	
导热系数		ASTM D5470	W/m.k	≥0.6	
介电强度		ASTM D149	Kv/mm	≥20	
体积电阻率		ASTM D257	Ω•cm	> 1*10 ¹⁴	
阻燃等级		UL-94	/	V1	





产品简介

- KXCP6410是一种双组份黑色环氧导热灌封胶。该产品具有较好的流动性，便于充分排除气泡，加温时能够快速固化，加温固化表面光洁度高，电气性能突出，且具有较高的导热性能以及较低的收缩率，能够在恶劣的环境中电子元件及组合件起防尘、防潮、防震及抗冲击、绝缘保护作用。

产品特点

- 较低的粘度、流动性优异；自动消泡，耐高低温性能好；绝缘性能优异；具有良好的防水防潮性能。

典型性能

A组分液体性能	外观	黑色/白色粘稠液体	测试标准
	粘度25℃	10800±1000mPa•s	ASTM D 2196
	密度25℃	1.75±0.05 g/cm³	GB/T 6750
B组分液体性能	外观	棕红色粘稠液体	--
	粘度25℃	300±100mPa•s	ASTM D 2196
	密度25℃	1.10±0.05 g/cm³	GB/T 6750
混合性能	外观	黑色/白色粘稠液体	--
	重量比 (A:B)	8.31: 1	--
	适用时间min (25℃)	2h	--
	固化时间h (25℃)	24h	--
	固化时间h (95℃)	1h	--
固化后性能	硬度shore D	85±5	ASTM D 2240
	介电强度 Kv/mm	≥20	ASTM D 149
	体积电阻率Ω•cm	≥10 ¹⁴	GB/T 31838.7
	导热系数 W/(m•k)	≥1.0	ASTM D 5470
	剪切强度 Mpa (A1/A1)	≥12	ASTM D 1002
	密度g/cm³ @25℃	2.05±0.05	ASTM D 792
	收缩率	0.75%	GB/T 24148.9
	TG	100℃	GB/T 19466.2
	CTE (TG前)	41ppm/℃	GB/T 1036
	CTE (TG后)	200ppm/℃	GB/T 1036
	吸水率	0.16%	GB/T 1034
	使用温度范围	-55℃ - 200℃	--





产品简介

- 对标美国7091
- 单组份室温硫化硅橡胶
- 对金属基材无腐蚀，属于脱醇型硫化
- 优异的防潮防尘和电绝缘性能
- 对金属、玻璃和塑料基材有良好的粘接

典型应用

- 电子元器件的粘接固定
- 电子模块的密封

典型性能

项目	试验方法	单位	数值
外观	目测	-	膏状物
表干时间	GB/T 13477.5-2002	min	25
密度	GB/T 533-2008	g/cm ³	1.37
挤出率	3.3mm×0.6MP	g/min	210
热导率	ASTM D5470	W/m·K	2.0
拉伸强度	GB/T 528-2009	Mpa	2.5
断裂伸长率	GB/T 528-2009	%	350
邵 A硬度	GB/T 531-2008	HA	35
电气强度	GB/T 1695-2005	kV/mm	21
剪切强度 Al-Al	GB/T 7124-2008	Mpa	2.3

使用方法

- 用乙醇或丙酮将粘接件表面灰尘、油污等杂质擦洗干净，待溶剂挥发后进行涂胶施工。
- 胶料在 20~35℃，湿度≥50%环境下 24 小时后可以移动，粘接强度 7 天后达到最佳。
- 对于厚层密封，建议不要超过 5mm；超过 5mm 的涂层，每次刮涂 3mm左右，硫化后再继续下一次施工。

包装 贮存 运输

- 采用 100mL 铝管或 300ml 塑料筒包装
- 在 0~30℃、原包装密闭条件下的保质期为 6 个月
- 本使用完后应将包装管的塑料盖子旋紧，以防剩余胶料在管中硫化
- 按照非危险品运输

注意事项

- 本产品使用完后应将包装管的塑料盖子旋紧，以防剩余的胶在管中固化。
- 本产品对眼睛有刺激性，使用时不慎弄进眼睛，应立即用自来水冲洗，然后请医生诊治。





单组份导电银胶 KXS84-1

产品简介

- KXS84-1 是一款单组份导电银胶。其粘度低，流变性好，点胶工艺性能优异，高速点胶时，无拉丝和拖尾。且固化后，导电性能好，粘接强度高。该胶在半导体芯片的贴合上有广泛的应用，适用于全自动机器高速点胶。

产品特点

- 流变性好，点胶工艺性能优异；导电性好，粘接强度高，适用于全自动机器高速点胶。

典型性能

固化前性能	测试项目		单位	特定值	测试方法
	外观		/	银灰色膏体	目测
	粘度		Pa.s	8.5	Brookfield粘度计 @25°C
推荐固化条件： 175°C*60min					
固化后性能	密度		g/cm³	4.0	ASTM D792
	热膨胀系数（CTE）		ppm/°C	α1： 41	TMA
			ppm/°C	α2： 140	TMA
	体积电阻率		Ω•cm	1.01*10 ⁻⁴	四探针法
	导热率		W/m.k	2.5	Laser Flash
	粘接强度	剪切强度	Mpa	≥16	钢-钢
		推力	N	12	0.3mmSi Ag/Cu基板, @25°C
				> 100	2mmSi 芯片 Ag/Cu基板, @25°C

使用方法:

- 解冻: 使用前需将银胶解冻恢复至室温，解冻时针筒竖直放置，解冻时间1-2h。
- 使用: 银胶解冻后需在10h内使用完，建议室温25°C，湿度50%RH环境下使用。
- 固化: 175°C烘烤60min。

包装和存储:

- 包装规格分别为: 3CC/支; 5CC/支; 10CC/支; 30CC/支; 其他可根据客户要求定制。
- 保存最佳温度为-40°C-10°C，保质期为6个月。
- 注意: 产品在运输和储存的过程中，应注意防潮、防止污染、避免高温、避免阳光直射; 产品应保存在清洁、干燥、无明火的环境中。收到货后，请立即放入冰箱保存。





单组份导电银胶 KXS20E

产品简介

- 对标美国xx20E胶单组分导电环氧粘合剂
- 优异的粘接性能、高触变性、高可靠性
- 高导热、高导电性

典型应用

- 大功率LED或IC芯片的粘接
- 热管理材料

典型性能

项目	试验方法	单位	数值
外观	目测	-	银色膏状
体积电阻率	GJB 548B-2009	$\Omega\cdot\text{cm}$	$5.3\text{E-}4$
导热系数	激光闪射法	$\text{W/m}\cdot\text{K}$	6.2
芯片剪切强度	25°C刚-刚	MPa	≥ 15.0
	25°C下0.3mmSi芯, Ag/Cu	N	≥ 12
	25°C下2mmSi芯, Ag/Cu		≥ 100
粘度	CP51@5rpm, 25°C	cps	23000
触变指数	0.5rpm/5rpm	-	6.1
可操作时间	建议25°C/50%RH下	h	10
热失重	TGA,RT-300°C	%	0.25
热膨胀系数	Tg以下	ppm	29
	Tg以上	ppm	156
玻璃化温度	DSC法	°C	118

使用方法

- 解冻: 使用前需将银胶解冻恢复至室温, 解冻时针筒竖直放置, 解冻时间 1-2h。
- 使用: 银胶解冻后需在 10h 内使用完, 建议室温 25°C, 湿度 50%RH 环境下使用。
- 固化: 80°C下3-4h或100°C下烘烤 60min。
- 适用于高速点胶设备, 优异的流变特性不会在点胶过程中出现拖尾或者拉丝现象

包装 贮存 运输

- 包装规格包括 1 cc、3cc、5cc、10cc、30cc、1盎司、1磅等
- 本产品按非危险品运输, 本产品可在-40至-15°C、干燥环境下保存, 贮藏期为6个月

注意事项

- 本产品使用完后应将包装管的塑料盖子旋紧, 以防剩余的胶在管中固化
- 本产品对眼睛有刺激性, 使用时不慎弄进眼睛, 应立即用自来水冲洗, 然后请医生诊治





产品简介

- KX-6144 是一款单组份导电银胶。其导电性能好，粘接强度高，粘度高，便于工艺操作，广泛应用于镀银支架和印刷电路板基板，芯片贴合，电极引出，导线粘接和电路修补，以及其他电子元器件的粘接和固定。

产品特点

- 导电性能好，粘接强度高，可印刷和点胶，高可靠性；
- 耐环境试验性能好，能经受85℃+85%RH 1000h；
- 能经受波峰焊和回流焊5次，导电性能稳定。

典型性能

固化前性能	测试项目		单位	特定值	测试方法
	外观		/	银灰色流体	目测
	粘度		Pa.s	12.5	Brookfield粘度计 5rpm @25℃
	触变指数		/	4.5	0.5rpm/5rpm值
推荐固化条件： 90℃*1h 或 100℃*30min； 或120℃*15min； 或150℃*10S；					
固化后性能	玻璃化转变温度		℃	168	DSC法
	体积电阻率		Ω.cm	1.0*10 ⁻⁴	四探针法
	导热率		W/m.k	2.6	Laser Flash 法
	线膨胀系数		ppm/℃, α1	35	TMA
			ppm/℃, α2	127	TMA
	粘接强度	剪切强度	MPa	≥8	钢-钢
		推力	N	12	0.3mmSi芯片 Ag/Cu 基板 @25℃

使用方法:

- 解冻: 使用前需将银胶解冻恢复至室温，解冻时针筒竖直放置，解冻时间1-2h。
- 使用: 银胶解冻后需在10h内使用完，建议室温25℃，湿度50%RH环境下使用。
- 固化: 在以下条件下进行固化: 90℃*1h或100℃*30min； 或120℃*15min； 或150℃*10S；

包装和存储:

- 包装规格分别为: 3CC/支; 5CC/支; 10CC/支; 30CC/支; 其他可根据客户要求定制。
- 保存最佳温度为-40℃-10℃，保质期为6个月。
- 注意: 产品在运输和储存的过程中，应注意防潮、防止污染、避免高温、避免阳光直射；产品应保存在清洁、干燥、无明火的环境中。收到货后，请立即放入冰箱保存。





单组份导电银胶 KXS9480

产品简介

- KXS9480一款单组份导电银胶。该胶导电性能好，粘接强度高，可印刷和点胶；耐高温，可长期在200℃下使用；可靠性高。广泛应用于镀银支架和印刷电路板基板，芯片贴合，电极引出，导线粘接和电路修补，以及其他电子元器件的粘接和固定。

典型应用

- 镀银支架，印刷线路板基板，芯片贴合，电极引出，射频元件粘接等，以及LED、大功率LED、LED数码管、LCD、TR、IC、COB、PCBA、点阵块、显示屏、晶振、谐振器、蜂鸣器、陶瓷电容、半导体分立器件等各种电子元件和组件的封装以及粘接等领域。

典型性能

固化前性能	测试项目		单位	特定值	测试方法
	外观		/	银灰色膏体	目测
	粘度		Pa.s	53	Brookfield粘度计 5rpm, @25℃
	触变指数		/	6.05	0.5rpm/5rpm值
固化条件: 120℃*2h ; 150℃*1h					
固化后性能	玻璃化转变温度		℃	101	DSC
	体积电阻率		Ω.cm	1.0*10 ⁻⁴	四探针法
	线膨胀系数		ppm/℃, α1	83	TMA
			ppm/℃, α2	145	TMA
	粘接强度	剪切强度	Mpa	≥15	钢-钢
		推力	N	15	0.3mmSi芯片 Ag/Cu基板, @25℃
				> 100	2mmSi芯片 Ag/Cu基板, @25℃

使用方法:

- 解冻: 使用前需将银胶解冻恢复至室温，解冻时针筒竖直放置，解冻时间 1-2h。
- 使用: 银胶解冻后需在 10h 内使用完，建议室温 25℃，湿度 50%RH 环境下使用。
- 固化: 在以下条件下进行固化：120℃*2h或 150℃*1h;

包装、储存与运输:

- 包装方式: 3CC/支; 5cc/支; 10cc/支; 30cc/支; 其他可根据客户要求订制。
- 储存: 保存最佳温度为 -40~ -15℃，保质期为 6 个月。
- 运输: 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 产品在运输和储存的过程中，应注意防潮、防止污染、避免高温、避免阳光直射;
- 产品应保存在清洁、干燥、无明火的环境中。收到货后，请立即放入冰箱保存。





产品简介

- 对标美国固美丽584XX0029胶，双组分室温固化导电环氧粘合剂；
- 优异的粘接强度、低粘度填缝施胶性、优良的导电性；

典型应用

- 电路修复、元器件粘接与接地应用；EMI屏蔽；外壳的粘接和密封

典型性能

项目	指标	
组 分	甲组分	乙组分
外 观	银色膏体	银色膏体
粘度, cps	50000	55000
固化条件	25℃*48h; 或 60℃*4h; 或 80℃*2h	
钢钢剪切强度, MPa	≥10	
密度, g/cm³	4.24	
邵氏硬度, 邵D	85	
体积电阻率, Ω.cm	0.0006	
玻璃化转变温度, °C	95	
重量配比	1 : 1	
可操作时间	@25℃, 35-65分钟	
初固时间	@25℃, 5-8小时	
可使用温度范围, °C	-50~120	
线膨胀系数	Tg下32; Tg上160	

使用方法

- 用乙醇或丙酮将粘接件表面灰尘、油污清洗干净，待溶剂挥发后，进行涂胶施工；
- 打开包装，将A、B组份分别先搅拌均匀。用电子秤，称量A、B组份重量，按重量比A:B=1:1进行混合。将称量好的A、B组份混合均匀，至颜色和状态一致。将混合好的胶水涂于已清理干净的待粘接基材上，并略微施加压力进行基材的贴合，然后用夹具进行固定。推荐固化条件为：25℃*48h;或60℃*4h; 或80℃*2h;

包装 贮存 运输

- 包装规格包括 1 cc、3cc、5cc、10cc、30cc、1盎司、1磅等
- 本产品室温15-30℃、干燥环境下保存，贮藏期为6个月，开封后未用完的A、B组份应立即密封保存，防止水汽对胶水性能造成影响。

注意事项

- A组份在室温下易结晶而变稠，使用前可在60-80℃下烘烤10-15分钟至状态正常，再冷却至室温，可以维持4-6小时；
- 本产品对眼睛有刺激性，使用时不慎弄进眼睛，应立即用自来水冲洗，然后请医生诊治





产品简介

- KXS7000是一款单组份高温导电银胶。其导电性能好，粘接强度高，耐高温性能优异，广泛应用于镀银支架和印刷电路板基板，芯片贴合，电极引出，导线粘接和电路修补，以及其他电子元器件的粘接和固定。

产品特点

- 导电性能好，粘接强度高
- 耐高温，可长期在250℃下使用
- 高可靠性

典型应用

- 镀银支架，印刷线路板基板，芯片贴合，电极引出，射频元件粘接等，以及LED、大功率LED、LED数码管、LCD、TR、IC、COB、PCBA、点阵块、显示屏、晶振、谐振器、蜂鸣器、陶瓷电容、半导体分立器件等各种电子元件和组件的封装以及粘结等领域。

典型性能

固化前性能	测试项目		单位	特定值	测试方法
	外观		/	银灰色膏状	目测
	粘度		Pa.s	8.8	Brookfield粘度计 5rpm,@25°C
	触变指数		/	4.05	0.5rpm/5rpm值
推荐固化条件： 150°C*30min					
固化后性能	玻璃化转变温度		°C	245	DSC
	体积电阻率		Ω·cm	1.0*10 ⁻³	四探针法
	线膨胀系数		ppm/°C, α1	33	TMA
			ppm/°C, α2	152	TMA
	粘接强度	剪切强度	MPa	≥15	钢-钢
		推力 <td rowspan="2">N</td> <td>15</td> <td>0.3mmSi芯片 Ag/Cu 基板, @25°C</td>	N	15	0.3mmSi芯片 Ag/Cu 基板, @25°C
				> 100	2mmSi芯片 Ag/Cu 基板, @25°C

使用方法

- 解冻: 使用前需将银胶解冻恢复至室温，解冻时针筒竖直放置，解冻时间 1-2h。
- 使用: 银胶解冻后需在 16h 内使用完，建议室温 25℃，湿度 50%RH 环境下使用。
- 固化: 在以下条件下进行固化：150℃*30min。

包装 贮存 运输

- 包装规格包括 3cc、5cc、10cc、30cc，其它可根据客户要求定制。
- 本产品最佳保存温度为-40 ~ -15℃环境下保存，保质期为12个月；保存温度为0 ~ 5℃，保质期为半年。
- 本产品按非危险品运输。

注意事项

- 本产品在运输和储存过程中应注意防潮、防止污染、避免高温、避免阳光直射，产品应保存在清洁、干燥、无明火的环境中。收到货后，请立即放入冰箱保存。





产品简介

- KX-380系列 属于单组份耐温高强环氧胶粘剂。其特点为低温固化，使用温度范围为-55℃~250℃；KX-380-1使用温度范围-55℃~180℃，单组份包装，使用方便。低温快速固化，粘接强度好。具有优良的触变性。

典型应用

- 主要用于磁电机铁氧体的粘接和电子元件的粘接，适合金属、玻璃、陶瓷、硬质橡皮、水泥、塑料、木材等材料的粘接。

典型性能

项目	KX-CD-380	KX-CD-380-1
外观	灰色稠状物	灰色稠状物
触变指数	5	4
密度 (g/cm3)	1.22	1.22
剪切强度 25℃ MPa	18	18
剪切强度150℃ MPa	20	10
剪切强度180℃ MPa	9	3.9
剪切强度 220℃ MPa	2	/
体积电阻率 Ω.m	4.9×10 ¹³	/
击穿电压 kv/mm	24.4	/
邵氏D硬度	90	90
玻璃化转变温度Tg °C	154	145
储存期 d (0-5℃)	180	180





产品简介

- 耐高温磁芯粘接胶KXS54是一种单组分低温储存环氧胶，加热固化后可广泛用于磁芯粘结。KXS54具有较高的玻璃化转变温度，热性能高，抗冲击和振动的能力优异。同时其线性膨胀系数低，柔韧性好，对元器件产生的应力较小，并对各种基材表现出优异的粘合性。

典型性能

- 低应力,抗冲击振动
- 绝缘性能优异,粘接性好

固化前	测试项目	KXS54	
	外观	黑色	目视
	粘度 (25℃, cp)	13600±2000mPa•s	ASTM D 2196
	适用时间 (25℃)	7天	-
	固化时间h(150℃)	1h	-
	建议储存条件	@-5~-10℃ 6个月	-
固化后	硬度 shore D	80	GB/T 2411-2008
	介电强度 KV/mm	≥20	ASTM D149
	体积电阻率 Ω.cm	≥10 ¹⁴	GB/T 1410-2006
	剪切强度 MPa (Al/Al)	≥15.0	GB/T 7124-2008
	玻璃化转变温度 °C	155	GB/T 19466.2
	CTE(Tg前)ppm/°C	35	
	CTE(Tg后)ppm/°C	120	
	重量损失@200℃	0.02%	ASTM D3850
	耐温范围 °C	-50~350	-

使用方法:

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 从冰箱取出后，在解冻时将注射器垂直放置；回温至25℃，开封前务必清除水汽。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染；解冻后的产品避免重新冻结。
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输:

- 塑料管包装，10cc、30cc、55cc、200cc支装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 对于高强度的结构粘接，去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 使用手套，尽量减少皮肤接触，不要用溶剂清洗双手；
- 为获得更大的粘接强度，推荐双面涂胶并且材料施工注意事项之间的粘接间隙在0.08-0.35mm之间；
- 固化过程中采用适当夹具并且保证不要产生粘接部件之间的相对位移，固化前清楚多余的余胶；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。





产品简介

- KXS6593是一种单组份环氧结构胶。该结构胶兼具较高的导热和粘结性能。可抗冷热交变性能，耐高温老化性能和绝缘性能，广泛用于电子线路板上部分电子元件的灌封、涂敷保护、粘接密封及加固，此外，该结构胶施胶操作方便，耐高温性能突出，工作寿命长。

典型性能

固化前性能	测试项目	KXS6593	
	外观	白色	目视
	粘度（25℃， cp）	22000	
	工作寿命	@25℃ 7天	
	保质期	@-5 ~ 10℃ （从生产日期起） 半年	
	固化条件	110℃ 1h+150℃ 1.5h	
固化后性能	拉伸剪切强度 (Al/Al)	≥12	GB/T 7124-2008(MPa)
	绝缘强度	≥18	ASTM D149 KV/mm
	导热系数	≥1.0	Hot disk 方法 .W/(m•k)
	体积电阻率	3.2x10 ¹⁴	GB/T 1410-2006(Ω.cm)
	玻璃化转变温度	207℃	
	温度使用范围	-45℃ ~ 500℃	
*上述固化概况是指南建议。固化条件（时间和温度）可以根据客户的经验和应用要求，以及客户固化设备，烤箱负载和实际烤箱温度而变化。			

使用方法

- 打开包装之前，解冻60分钟。
- 清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等。
- 施胶：根据需要方式施胶。
- 固化：根据推荐的硬化程序进行硬化。

存储、运输和包装

- 避免挤压、碰撞和硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射。
- 保存条件：-5 ~ 10℃冷藏保存。
- 保存期限：在原包装内上述条件为半年。
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项

- 预先实验是保证良好的使用效果的必要条件。
- 开封后，未使用完须严格密封冷藏保存。
- 避免与皮肤或眼睛接触，如不慎接触，立即用清水冲洗并看医生，工作室应保持良好的通风，必要时穿戴防护工具。
- 如有部分不慎被胶所污染，则尽早用酒精等溶剂清洗。如胶已固化，需用刀片切割后再用溶剂擦拭。





产品简介

- KXS2605是一种单组份柔性的环氧结构胶。该胶触变优异、可在加温条件下快速固化，可加温拆解，便于维修，特别适用于BGA/CSP/uBGA装配后的封边保护。具有卓越的绝缘性能，胶层具有良好的机械性能以及耐化学性、抗漏电性能，广泛用于电子线路板上部分电子元件、芯片粘接密封及加固。

典型性能

固化前性能	测试项目	KXS2605	
	外观	黑色	目视
	粘度 (25℃, cp)	24000±3000	
	触变指数 (25℃, cp)	4.82	
	工作寿命	@25℃ 3天	
	保质期	@-5℃ ~ 10℃ 半年	
	固化条件	150℃ 30min	
固化后性能	邵氏硬度 (D)	≥80	GB/T2411-2008
	拉伸剪切强度 MPa (A1/A1)	≥12	GB/T 7124-2008
	绝缘强度 KV/mm	≥20	ASTM D149
	体积电阻率 Ω.cm	1.9*10 ¹⁴	GB/T 1410-2006
	Tg温度 °C	95	GB/T 19466.2
	CTE(TG前)	29ppm/°C	GB/T 1036
	CTE(TG后)	91ppm/°C	GB/T 1036
	使用温度范围	-40 ~ 180℃	
	可返修温度	135℃	
上述固化概况是指南建议。固化条件（时间和温度）可以根据客户的经验和应用要求，以及客户固化设备，烤箱负载和实际烤箱温度而变化。			

使用方法:

- 打开包装之前，解冻60分钟。
- 清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等。
- 施胶、固化：根据需要方式施教，并根据推荐的硬化程序进行硬化。

包装、储存与运输:

- 塑料管包装，30cc支装，6个月保质期；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 保存条件：-20℃冷冻保存；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 开封后，未使用完须严格密封冷藏保存；
- 避免与皮肤或眼睛接触，如不慎接触，立即用清水冲洗并看医生，工作室应保持良好的通风，必要时穿戴防护工具。
- 如有部分不慎被胶所污染，则尽早用酒精等溶剂清洗。如胶已固化，需用刀片切割后再用溶剂擦拭。





产品简介

- KXS2605B 是一种单组份、无溶剂高温固化的环氧结构胶。该结构胶具有较高的粘接性能。完全固化的环氧树脂，有卓越的抗冷热交变性能，耐高温老化性能和绝缘性能，胶层具有良好的机械性能以及耐化学性、抗漏电性能，广泛用于电子线路板上部分电子元件、芯片粘接密封及加固，此外，该结构胶施胶操作方便，可调控性高，工作寿命长。

典型性能

固化前性能	测试项目	KXS2605B	
	外观	黑色	目视
	粘度 (25℃, cp)	200000±10000	
	触变指数 (25℃, cp)	3.95	
	工作寿命	@25℃ 3天	
	保质期	@-20℃ ~ -40℃ 6个月	
	固化条件	130℃ 10min	
固化后性能	硬度 (D)	≥85	ASTM D 2240
	拉伸剪切强度 Mpa (A1/A1)	≥12	GB/T 7124-2008
	绝缘强度 KV/mm	≥18	ASTM D149
	体积电阻率 Ω.m	1.0*10 ¹⁴	GB/T 1410-2006
	Tg温度 °C	114	GB/T 19466.2
	CTE(TG前)	31ppm/°C	GB/T 1036
	CTE(TG后)	94ppm/°C	GB/T 1036
	使用温度范围	-40 ~ 200°C	
	返修温度	130°C	
上述固化概况是指南建议。固化条件（时间和温度）可以根据客户的经验和应用要求，以及客户固化设备，烤箱负载和实际烤箱温度而变化。			

使用方法:

- 打开包装之前，解冻60分钟。
- 清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等。
- 施胶、固化：根据需要方式施教，并根据推荐的硬化程序进行硬化。

包装、储存与运输:

- 塑料管包装，30cc支装，6个月保质期；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 保存条件：-40℃冷冻保存；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 开封后，未使用完须严格密封冷藏保存；
- 避免与皮肤或眼睛接触，如不慎接触，立即用清水冲洗并看医生，工作室应保持良好的通风，必要时穿戴防护用品。
- 如有部分不慎被胶所污染，则尽早用酒精等溶剂清洗。如胶已固化，需用刀片切割后再用溶剂擦拭。





产品简介

- KXS8410-99 是一种单组分高温固化的环氧底部填充胶，广泛应用于芯片倒装工艺（Flip-Chip）中。它具有良好的流动性，对芯片、基板、互连凸块之间的间隙填充性高，在热循环中提供极高的可靠性，可过多轮波峰焊。耐高温老化性能和绝缘性能，胶层具有良好的机械性能以及耐化学性、抗漏电性能，广泛用于电子线路板上部分电子元件的涂敷保护、粘接密封及加固。

典型性能

- 良好的流动填充性能
- 各基材粘结性优异
- 低 CTE、低应力；极好的共平面性/低弯曲；出胶顺畅

固化前	测试项目	KXS8410-99	
	外观	黑色	目视
	粘度 (25°C, cp)	46320	
	工作寿命@25°C	7天	
	保质期@-20°C	6个月	
	固化条件	120°C,60min/150°C,30min	
固化后	邵氏硬度 (D)	≥85	GB/T 2411-2008
	拉伸剪切强度 Mpa (A1/A1)	≥10	GB/T 7124-2008
	绝缘强度 KV/mm	≥20	ASTM D149
	导热系数 W/(m·k)	≥1.0	ASTM D 5470
	体积电阻率 Ω.cm	1.7*10 ¹⁵	GB/T 1410-2006
	弯曲强度MPa	100	GB/T 15022.2
	玻璃化转变温度°C	135	GB/T 19466.2
	CTE(TG前) ppm	25	GB/T 1036
	CTE(TG后) ppm	79	GB/T 1036
上述固化概况是指南建议。固化条件（时间和温度）可以根据客户的经验和应用要求，以及客户固化设备，烤箱负载和实际烤箱温度而变化。			

使用方法:

- 打开包装之前，室温解冻1-2小时。
- 清洁表面：将被粘或被涂物表面整理干净，除去锈迹、灰尘、油污等。
- 施胶、固化：根据需要方式施胶，并根据推荐的硬化程序进行硬化。

包装、储存与运输:

- 塑料管包装，30cc支装，在原包装内6个月保质期；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 保存条件：-20°C冷冻保存；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 预先试验是保证良好使用效果的必备条件；开封后，未使用完须严格密封冷藏保存；避免与皮肤或眼睛接触，如不慎接触，立即用清水冲洗并看医生；工作室应保持良好的通风，必要时穿戴防护工具，如有部分不慎被胶所污染，则尽早用酒精等溶剂清洗。如胶已固化，需用刀片切割后再用溶剂擦拭。





产品简介

- SMT贴片红胶KXS3609 是单一组份常温储藏受热后迅速固化的环氧树脂胶粘剂，该胶粘剂具有粘度流动性，温度特性，润湿特性等，非常适合应用于SMT工艺，胶点形状非常容易控制，储存安定性好，且具有优良的耐热冲击性和优良的电气特性。

典型性能

- 触变性好；耐高温老化性好；绝缘性能优异；粘接性好

	测试项目	KXS3609	
	外观	红色	目视
固化前	粘度 (25°C, cp)	200000±10000mPa•s	ASTM D 2196
	触变指数 @25°C	6.75	ASTM D 2196
	适用时间 (25°C)	3天	-
	固化时间h(100°C)	1h	-
固化后	硬度 shore D	85±5	GB/T 2411-2008
	介电强度 KV/mm	≥20	ASTM D149
	体积电阻率 Ω.cm	≥10 ¹⁴	GB/T 1410-2006
	剪切强度 Mpa (A1/A1)	≥15	GB/T 7124-2008
	拉拔强度N	≥50	TM-650 2.4.42
	过260°C波峰焊拉拔强度保留初始强度的百分比%	100	TM-650 2.4.42
	密度g/cm ³ @25°C	1.27±0.05	ASTM D 792
	玻璃化转变温度°C	103	GB/T 19466.2
	热膨胀系数ppm	33	GB/T 19466.2
	耐温范围 °C	-40 ~ 300	-

使用方法:

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 从冰箱取出后，在解冻时将注射器垂直放置；回温至25°C，开封前务必清除水汽。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染；解冻后的产品避免重新冻结；
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输:

- 塑料管包装，10cc、30cc、55cc、200cc支装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 对于高强度的结构粘接，去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 使用手套，尽量减少皮肤接触，不要用溶剂清洗双手；
- 为获得更大的粘接强度，推荐双面涂胶并且材施工注意事项之间的粘接间隙在0.08-0.13mm之间。
- 固化过程中采用适当夹具并且保证不要产生粘接部件之间的相对位移，固化前清楚多余的余胶；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。





产品简介

- 中性单组份室温固化半透明硅橡胶,对标美国道康宁3140
- 固化后成弹性体对金属无腐蚀性
- 可在-60~200℃范围内长期使用并有优异的耐紫外光、耐臭氧性能及良好的电绝缘性

典型应用

- 对玻璃、陶瓷、金属等有良好的粘接性能
- 电子元器件的封装
- 工业电器设备的涂复、粘接、密封

典型性能

项目	试验方法	单位	数值
外观	目测	-	半透明膏状
拉伸强度	GB/T 528-2009	Mpa	3.0
断裂伸长率	GB/T 528-2009	%	300
邵 A硬度	GB/T 531-2008	HA	20
电气强度	GB/T 1695-2005	kV/mm	15
撕裂强度	GB/T 529-2008	Kn/m	6.0

使用方法

- 用乙醇或丙酮将粘接件表面灰尘、油污清洗干净，待溶剂挥发后，进行涂胶施工。
- 将胶少量均匀涂于粘接面，然后把粘接件复合在一起，施加一定压力，放置在 20~35℃，湿度≥50%环境下，24 小时后可以移动，粘接强度 1 周后达到最佳。
- 对于厚层密封，厚度一般不要超过5mm；超过5mm 的涂层，每次刮涂3mm 左右，固化后再继续下一次施工。

包装 贮存 运输

- 本产品有 100g 铝管包装或 300ml 塑料筒包装。
- 本产品按非危险品运输。
- 本产品应在低温、干燥环境下保存，贮藏期为半年6个月。

注意事项

- 本产品使用完后应将包装管的塑料盖子旋紧，以防剩余的胶在管中固化。
- 本产品对眼睛有刺激性，使用时不慎弄进眼睛，应立即用自来水冲洗，然后请医生诊治。





产品简介

- 对标美国RTV3145透明版
- 中性单组份室温固化硅橡胶
- 固化后对金属无腐蚀性，高强度、高断裂伸长率
- 可在-60~200℃范围内长期使用并有优异的耐紫外光、耐天候老化及良好的电绝缘性

典型应用

- 工业电器设备的涂复、粘接，具有防潮、防震、绝缘作用
- 飞机座舱、飞行舱等的密封、隔热材料
- 航天、航空、电子电器行业理想的弹性密封剂

典型性能

项目	试验方法	单位	数值
外观	目测	-	半透明膏状
拉伸强度	GB/T 528-2009	Mpa	5.5
断裂伸长率	GB/T 528-2009	%	550
撕裂强度	GB/T 529-2008	Kn/m	15
邵 A硬度	GB/T 531-2008	HA	30
电气强度	GB/T 1695-2005	kV/mm	15
剪切强度 Al-Al	GB/T 7124-2008	Mpa	1.0

使用方法

- 用乙醇或丙酮将粘接件表面灰尘、油污清洗干净，待溶剂挥发后，进行涂胶施工。
- 将胶少量均匀涂于粘接面，然后把粘接件复合在一起，施加一定压力，放置在 20~35℃，湿度≥50%环境下，24 小时后可以移动，粘接强度 1 周后达到最佳。
- 对于厚层密封，厚度一般不要超过5mm；超过5mm 的涂层，每次刮涂3mm 左右，固化后再继续下一次施工。

包装 贮存 运输

- 本产品有 100g 铝管包装或 300ml 塑料筒包装。
- 本产品按非危险品运输。
- 本产品应在低温、干燥环境下保存，贮藏期为6个月。

注意事项

- 本产品使用完后应将包装管的塑料盖子旋紧，以防剩余的胶在管中固化。
- 本产品对眼睛有刺激性，使用时不慎弄进眼睛，应立即用自来水冲洗，然后请医生诊治。





产品简介

- 对标美国SE4420
- 单组份室温固化，固化过程无低分子放出
- 优异的导热性能和电气绝缘性能

典型应用

- 电路板绝缘、防潮、防漏电、防尘防腐蚀、防老化等

典型性能

测试项目	试验方法	单位	特定值
外观	目测	/	白色膏状
密度	GB/T 533-2008	g/cm ³	2.26
固化温度		°C	25
热导率	ASTM D5470	W/m·K	1.0
拉伸强度	GB/T 528-2009	Mpa	3.2
邵A硬度	GB/T 531-2008	HA	75
电气强度	GB/T 1695-2005	kv/mm	15
剪切强度Al-Al	GB/T 7124-2008	Mpa	1.2

使用方法

- 准备: 格基材用无水乙醇、丙配等溶剂擦拭干净共琼干
- 涂胶: 用一胶机或者手工将胶料涂数于需粘接部位
- 固化: 室温百化实现全部物理性有的90%以上需要4-7小时

包装 贮存 运输

- 本产品用牙膏管、塑料管或塑料桶包装
- 本产品按非危险品运输

注意事项

- 本产品使用完后应将包装管的塑料盖子旋紧，以防剩余的胶在管中固化。
- 本产品对眼睛有刺激性，使用时不慎弄进眼睛，应当立即用自来水冲洗，然后请医生诊治。





产品简介

- 对标美国陶熙SE4450
- 单组份加成型加热固化
- 加热固化，固化过程无低分子放出
- 优异的导热性能和电气绝缘性能
- 能与多种基材形成稳定可靠的自粘接

典型应用

- 电子元器件的导热粘接
- 芯片封装

典型性能

项目	试验方法	单位	数值
外观	目测	-	固化前白色膏状 固化后黑色弹性体
密度	GB/T 533-2008	g/cm ³	2.8
固化温度		°C	不低于150
热导率	ASTM D5470	W/m·K	2.0
拉伸强度	GB/T 528-2009	Mpa	3.2
断裂伸长率	GB/T 528-2009	%	360
邵 A硬度	GB/T 531-2008	HA	25
电气强度	GB/T 1695-2005	kV/mm	15
剪切强度 Al-Al	GB/T 7124-2008	Mpa	1.2

使用方法

- 准备: 将基材用无水乙醇、丙酮等溶剂擦拭干净并晾干。
- 涂胶: 用点胶机或者手工将胶料涂敷于需粘接部位。
- 固化: 150°C以上的温度下固化成型，固化时间与传热和制件大小相关，温度越高，固化越快。

包装 贮存 运输

- 本产品有用牙膏管、塑料管或塑料桶包装
- 本产品按非危险品运输
- 贮存温度低于零下 10°C，原包装密闭条件下保质期为 6 个月以上

注意事项

- 本产品使用完后应将包装管的塑料盖子旋紧，以防剩余的胶在管中固化。
- 本产品对眼睛有刺激性，使用时不慎弄进眼睛，应立即用自来水冲洗，然后请医生诊治。





产品简介

- KXS612是一款双组份加成型有机硅凝胶，应用于电子元器件的透明灌封，具有低粘度，适于灌封操作的特点。
- 优异的耐高低温性能，可在-50~200℃条件下使用；
- 铂金催化，无低分子放出，升高温度可加速固化。

典型性能

	测试项目	测试条件	单位	典型性能
固化前性能	外观			透明流体
	A组份粘度	GB/T 10247-2008	mpa.s	1500
	B组份粘度	GB/T 10247-2008	mpa.s	800
	混合比		质量比	A:B=1:1
	25℃可操作时间		h	1
固化后性能	密度	GB/T 533-2008	g/cm ³	0.98
	锥入度	GB/T 269-1991		300
	击穿电压强度	GB/T 1695-2005	KV/mm	20
	体积电阻率	GB/T 1692-2008	Ω.cm	10 ¹⁴
	介电常数	GB/T 1693-2007	1MHz	2.8

使用方法:

- 称量：按照比例准确称量A/B组份，并混合均匀。
- 脱泡：将混合后的胶料放入真空装置中脱出气泡。
- 灌胶：先用无水乙醇和丙酮将基材清洗干净，再进行灌封操作。
- 固化：胶料在25℃条件下约10小时即可固化。
- 胶料为铂金催化体系，应避免与含硫、磷、胺氮、有机锡、重金属、助焊剂等物质接触，否则会导致胶料不固化。

包装、储存与运输:

- 胶料的A/B组份采用20KG塑料桶分别包装。
- 在0~30℃、原包装密闭条件下的保质期为6个月。
- 按照非危险品运输。





产品简介

- 可原位替换瓦克920LT
- 可用于灌封、加成固化的双组分硅橡胶，固化后为柔软的硅胶
- 双组分，1：1混合比，可快速固化
- 非常低的粘度，硫化后形成软凝胶，且离子含量较低
- 在-100℃到+200℃之间可保持恒定的性能

典型应用

- 适用混合电路的灌封，提供粘接、抗振动、抗冲击性能

典型性能

项目	单位	数值
填料含量	%	50
外 观	-	透明
使用期	h	4
粘度	CP·s	220
可操作性时间	23℃增加至1000mPa·s/min	10
	23℃增加至20000mPa·s/min	100
凝胶时间	70℃下min	5
固化条件	常温25℃/h	24
	固化温度110℃/min	30
	固化温度130℃/min	20
	固化温度150℃/min	10
固化后密度	g/cm ³	0.98

使用方法

- 将被粘物表用清理干净，注意有含硫材料、增塑剂、聚氨酯、含胺材料和有机金属化合物，尤其是有机锡化合物容易造成胶体中毒；
- 建议真空灌封以减少气泡混入

包装 贮存 运输

- 产品需贮存在5℃~30℃之间。，建议冰箱冷藏。
- 原包装密闭条件下保质期为 6个月，请注意防潮，及时盖紧瓶盖。

注意事项

- 本产品对眼睛有刺激性，使用时不慎弄进眼睛，应立即用自来水冲洗，然后请医生诊治





产品简介

- 国产化替代美国道康宁1-2577敷型涂料
- 单组分室温固化有机硅树脂

产品特点

- 优异的耐磨损性,耐湿性
- 可升温加速固化,缩短固化时间
- 良好的介电性能
- 固化后形成牢固、干燥的表面
- 中等粘度,易于喷涂

典型应用

- 电路板绝缘、防潮、防漏电、防尘防腐蚀、防老化等

	测试项目	单位	特定值
固化前性能	颜色	/	淡黄透明色
	粘度	mPa.s	800~1000
	指示性	/	紫外荧光
	表干时间/25℃	min	10
	适用期	h	4
	电气强度	Kv/mm	≥18
	介电常数/100kHz	/	≤2.7
	介电损耗/100kHz	/	≤0.01
	体积电阻率	Ω·cm	2.0E+15
固化后性能	ShoreA硬度	/	30
	抗拉强度	MPa	2.3
	断裂伸长率	%	60%
	阻燃	/	94V1

三防性能

- 192h (设备实验室环境试验方法第11部分: 盐雾试验)
- 25个周期 (装备实验室环境试验方法第9部分 : 湿热试验)
- 1级 (设备实验室环境试验方法第10部分: 霉菌试验)

适用期

- KXS1-2577 的适用期与所选择的涂敷方法有关。为了延长其适用期应当尽可能避免与湿气接触,可以使用干燥空气或干燥氮气予以保护。

使用方法

- 通过喷涂、 刷涂 流动涂布、浸涂或自动方式进行涂敷。 还可根据施工工艺的需要加入 甲苯溶剂调节树脂的固体含量及粘度,以控制漆膜的厚度。

注意事项

- 硅树脂在使用加工过程中, 会有易燃易爆溶剂挥发出来,应注意加强操作现场通风, 注意防火,严格断绝火源。操作人员应注意劳动保护。硅树脂在使用加工过程中,所用设备器具必须是洁净的, 并严格防止粉尘异物的混入和带入, 否则会使制品的电气绝缘性能下降。酸、 碱、 有机酸盐和胺类等化合物对硅树脂有加速固化的作用, 并影响耐热和电性能,因此,硅树脂应严格与这些物质隔离开来

包装 贮存 运输

- 20kg塑料桶分别包装或按用户要求贮存在0C~30C之间,原包装密闭条件下保质期为6个月以上。
- 贮存期超过保质期并不意味着本产品完全不可用, 在这种情况下相关性能都应做质量检测以保其品质。
- 胶料按非危险品运输。





产品简介

- KXS200A是柔韧、透明有机硅改性三防漆，用于为电子电路提供特殊保护，符合欧洲及美国的最高防护标准。通过的认证包括英国军标（MOD）DEF-STAN 59/47 Issue 4，美国保险商实验所UL746CQMJU2等。

产品特点

- 对航空、汽车工业中的溶剂、润滑剂和化学品，具有极佳的耐受性
- 在各种气候条件下对不同的基材均具有极好的附着性，包括标准 MIL-STD-810C中规定的各种情况
- 紫外灯下发出荧光，便于检查
- 极宽的工作温度范围
- 可焊透而不会产生有毒气体（不含异氰酸酯）
- 不腐蚀铜、锌板（不含苯酚）
- 优异的防潮、防霉、防盐雾腐蚀&防紫外线特性
- 固化后的漆膜可用专用去除凝剂清除
- 按DEF-STAN 59-4/2 Annex C标准的各种频率，具有优异的绝缘性

	测试项目	特定值
液体性能	外观	透明浅麦色液体
	比重（密度）@20℃	0.78（气雾剂） g/ml
	VOC含量	73%(气雾剂)
	闪点	< 23℃（气雾剂）
	固体含量	27%(气雾剂)
	粘度@20℃	200cPs
	表干	20min
	推荐干燥时间	2 hrc@20℃后：2-24hrs@90℃~120℃（120℃下干燥可达到最佳耐溶剂性）
	涂敷面积@25μm	2.16m ² （200ml气雾剂）
干膜性能	颜色	无色
	工作温度范围	-70℃~+120℃
	可燃性	自熄（UL94）
	热循环	符合MIL-1-46058C标准
	膨胀系数	90ppm
	绝缘强度	90kV/mm
	介电常数	3.95@1MHz
	绝缘电阻	1*10 ¹⁵ Ohms/cm(DEF-STAN 59/47)
	耗散系数@1MHz@25℃	0.037@1MHz 25℃
	耐潮（MIL-1-46058C）	符合标准





产品简介

KXS1B31是透明丙烯酸三防漆，该产品不含芳烃类溶剂，具有优异的PCB防护性能，尤其是对于高湿度环境中工作的PCB防护。KXS1B31可用于浸涂、刷涂以及喷涂等。工作温度范围宽，可防止霉菌生长；紫外灯下发出荧光，便于检查；耐包括酸碱在内的多种化学品，不腐蚀锡、锌板。可焊透而不会产生有毒气体（不含异氰酸酯）；具有优异的机械性能，包括耐低温性和耐磨损性。

典型性能

液体性能	
外观	无色透明液体
密度@20℃	0.949g/ml
固体含量@120℃ 2h	25.79%
粘度@20℃	300±50cPs
表干	10-20mins
推荐干燥时间	24hrs@20℃
	2-4hrs@60℃
干膜性能	
颜色	无色透明
工作温度范围	-65℃-150℃
热循环（MIL-1-46058C）	符合标准
绝缘强度	17kV/mm
介电常数	2.5
绝缘电阻	0.8*10 ¹⁵ Ohms

使用方法

- KXS1B31可以喷涂、浸涂或刷涂。膜层厚度取决于涂覆方式（标准厚度为25-75μm）。
- 施工时保持良好的通风，基材在涂敷前彻底清洁，以确保三防漆与基材之间得到很好的附着力。
- 焊剂残渣需清除干净，以免留在PCB板上造成腐蚀。
- 施工时，环境温度不低于16℃或相对湿度不超过75%。

包装 贮存 运输

- 包装规格1L灌装
- 本产品按非危险品运输，本产品干燥环境下保存，贮藏期为24个月。

注意事项

- KXS1B31含UV示踪剂，涂敷后可在紫外灯下检查是否完全、均匀地涂敷。反射的紫外光越强，表明涂层越厚。
- 本产品对眼睛有刺激性，使用时不慎弄进眼睛，应立即用自来水冲洗，然后请医生诊治。





产品简介

KXS290是一种单组份、低粘度、高强度、耐介质优良的圆柱固持型厌氧胶。本产品两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时实现快速固化。适用于金属固持键与轴、轴承、微电机转子轴、衬套等间隙或过盈配合，可加热(250℃)拆卸。

典型性能

主要成分	甲基丙烯酸酯
外观	绿色粘稠状均质液体
比重 g/cm ³ 20℃	1.01±0.02
闪点 °C	> 108
粘度 mPa•s 25℃	100 ~ 300
破坏扭矩 Nm	13
压剪强度 Mpa	≥20
初固时间 min 25℃	3 ~ 30
耐温 °C	-40 ~ 150
最大填充间隙 mm	0.13
保质期	> 12个月

使用方法：

- 清洗干净被粘物表面的油脂并干燥。
- 涂胶：
 - 滑动配合：在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶，并在装配时转动，以确保覆盖良好。
 - 压入配合：在销/圆柱的周围及轴环内部涂胶，再高速压入配合。
 - 冷缩配合：需在部件上均匀涂胶。若需加热毂进行装配，应在销/圆柱上涂胶；若需冷却销/圆柱，应在毂上涂胶；若加热、冷却都需进行，则需在冷却部件上涂胶。
- 装配好的部件在没有完全固化前不要移动。

包装：

- 50ml/支，10 支/盒、60 支/箱；
- 250ml/支，10 支/盒，60 支/箱；

储存与运输：

- 避免挤压、碰撞或硬划伤。
- 防止高温、雨淋或阳光直射。
- 保存条件：15 ~ 25℃ 湿度 < 55%RH。
- 保存期：在原包装内上述条件为12 个月。
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。





产品简介

- KXS1087是一种快干型的高强度聚氨酯结构胶粘剂，该胶粘剂具有较高的粘接性能。完全固化的聚氨酯树脂，具有附着力好，柔软有弹性，绿色环保的特点，适用于PU、尼龙布及防水尼龙布粘接。

典型性能

- 高附着力；适用多种基材；防霉；操作方便

	测试项目	KXS1087	
	外观	A组分：透明色 B组分：透明色	目视
固化前	粘度（25℃，cp）	20000±1000mPa·s	ASTM D 2196
		30000±1000mPa·s	
	混合质量比	280:1	-
	夹固时间(25℃)	5-10min	-
	固化时间(25℃)	12h	-
	固化时间(100℃)	1h	-
固化后	100%定伸模量MPa	2-4	GB/T 528-2009
	抗拉强度MPa	15-30	
	伸长率%	600-900	
	剥离强度N/cm	≥500	GB/T 2792-2014

使用方法：

- 用丁酮清洁两个粘接基材表面，静置5分钟以上；
- 将KXS1087与适量促进剂混合，搅拌均匀；
- 在待粘的基材表面刷上2层粘接剂，两层胶之间保持5至10分钟的干燥时间；
- 涂上最后一层胶15分钟后用丁酮润湿两个待粘接表面，待10-15s后将两个粘接面搭接上，并用手摇辊压匀；
- 基材常温下固化8小时以上或者100℃固化1小时。

包装、储存与运输：

- 塑料桶包装，1公斤、25公斤桶装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项：

- 对于高强度的结构粘接，去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 为获得更大的粘接强度；
- 固化过程中采用适当夹具并且保证不要产生粘接部件之间的相对位移，固化前清楚多余的余胶；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。





产品简介

- KXS1025是一种聚氨酯发泡密封胶。由 A、B 料混合搅拌后，反应成类似泡沫一样，孔径小、均匀细腻的发泡材料，发泡倍数为 31 倍（32 千克/立方），可以根据客户需求特调为其他倍数。发泡胶重量轻，材质坚硬，粘接性好，还具有防水、防腐蚀、绝缘等优良性能。

典型性能

- 高附着力；硬度高；密度低

固化前	测试项目	KXS1025	
	外观	A组分：琥珀色	目视
		B组分：棕褐色	
	粘度（25℃，cp）	11400±1000mPa·s	ASTM D 2196
		2000±500mPa·s	
	混合质量比	100:130	-
	发白时间(25℃)	25s	-
	凝胶时间(25℃)	3-5min	-
	完全固化时间(25℃)	24h	-
固化后	硬度shore D	D55	GB/T 2411-2008
	密度kg/m³	320	ASTM D 792
	吸水率%	< 3%	ASTM D 570
	抗压强度（形变10%）kPa	≥150	ASTM D 695
	耐温范围 °C	-40 ~ 120	-

使用方法：

- 准确称取AB组分质量，按比例混合；
- 将混合液进行快速搅拌，搅拌约5s后混合料内部出现发白现象；
- 持续搅拌至发热后（约30s），快速倒入需要填充的部位；
- 将灌封后的产品置于室温环境中，自动发泡；
- 以发泡温度降至常温为准，发泡结束，常温下固化24小时。

包装、储存与运输：

- 塑料桶包装，1公斤、25公斤桶装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项：

- 去除基材表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。





产品简介

- KXS800是一款单组份、高导热的有机硅凝胶材料，具有优良的导热性、低热阻、高压缩、贴服性好等特点。主要应用于需要迅速而有效地排出大量热的环境，该产品为膏状，使用灵活，即可用于点胶设备自动化操作，也可以手工涂敷使用。填充在需要散热的电子元器件的缝隙处，可以降低电子元器件工作产生的温度，延长工件寿命，并有效提高安全性、可靠性。

产品特点

- 高导热；高压缩；贴服性好；耐高低温，可耐受-50~200℃可自动点胶

典型性能

检测项目	参考标准	单位	典型数值
外观	目测	/	灰色膏体
粘度	ASTM D2196	cps	250,000~600,000
密度	ASTM D792	g/cm ³	3.40±0.05
导热系数	ASTM D5470	W/m.k	≥8.0
热阻系数	ASTM D5470	°C.in ² /W(@20psi)	≤0.075
介电强度	ASTM D149	kV/mm	≥8.0
体积电阻率	ASTM D257	Ω.cm	>1*10 ¹²
阻燃等级	UL-94	/	V0
重量损失	96h@100℃	%	≤0.5

使用方法:

- 清洁待涂胶部位，除去灰尘、油污等杂质。
- 将胶体涂布在施胶部位，并根据需要进行涂抹均匀。
- 施加适当的压力，确保胶体填充充分，贴合紧密。

包装、储存与运输:

- 塑料桶包装，1公斤、25公斤桶装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 远离儿童存放。
- 胶料密封贮存。
- 本品属非危险品，但勿入口和眼。

包装规格、储存与运输:

- 1kg/罐；30CC/支；55CC/支；其他规格可以根据客户需求进行订制；
- **储存:** 最佳储存温度：≤30℃，有效期：12个月。
- **运输:** 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。





产品简介

- KXS0007 使用含硅的基础油，具有很高的导热系数和极宽的工作温度范围，它所具有的 优异性能来自于成分中的各种金属氧化物 (陶瓷) 粉，这些绝缘材料的应用也确保了导热 脂接触到系统中其它部分时不会造成漏电。
- KXS0007 适于那些需要迅速而有效地排出大量热的环境。热源 (如半导体阻挡层) 产生 的热量在通过自由或强制对流排出前需要通过很多不同的材料层，需要注意的是如果将使用导热脂的界面的导热系数在系统中最小，即是速率决定点，通常需要导热脂帮助散热。 散热的速率取决于温差、层厚及材料的导热系数。

产品特点

- 即使在高温下仍具有极佳的导热系数；
- 优异的防爬性；工作温度范围宽，低挥发重量损失；使用经济、方便，无毒。

典型性能

检测项目	参考标准	单位	数值
外观	目测	/	灰色膏体
粘度	ASTM D2196	cps	250,000~400,000
密度	ASTM D792	g/cm ³	3.40±0.05
导热系数	ASTM D5470	W/m.k	≥7.0
介电常数	ASTM D150	/	4.5
介电强度	ASTM D149	kV/mm	≥5.0
体积电阻率	ASTM D257	Ω.cm	>1*10 ¹⁴
耐温范围	/	°C	-50~200
96hrs 小时后的重量损失@100°C	/	%	≤0.2

使用方法:

- 先将硅脂用刮刀手动搅拌均匀；将待涂硅脂的器件表面清理干净；
- 用刮刀将硅脂均匀涂抹在待涂布的器件上，涂薄薄一层即可。

包装、储存与运输:

- 塑料桶包装，1公斤、25公斤桶装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 远离儿童存放；胶料密封贮存。混合好的胶料一次用完，避免造成浪费；
- 本品属非危险品，但勿入口和眼；胶液接触一定量的以下化学物质会不固化。

包装规格、储存:

- **包装规格:** 300g/罐；500g/罐；其他规格可以根据客户需求进行订制；
- **储存:** 最佳储存温度：≤30°C，有效期： 6 个月。





产品简介

- 耐超低温环氧粘结胶KXS90是单一组份低温储藏加热固化的环氧树脂胶粘剂。该胶粘剂施工性好，具有较好的基材润湿特性，韧性好，基材附着力佳，绝缘性能好，非常适用于电子元器件的漏电防护。储存安定性好，操作方便，可耐超低温，且冷热冲击后性能表现优异。

典型性能

- 粘结性好
- 耐超低温
- 绝缘性能优异
- 耐冷热冲击性能好

	测试项目	KXS90	
	外观	白色/黑色	目视
固化前	粘度 (25℃, cp)	51080±2000mPa•s	ASTM D 2196
	适用时间 (25℃)	7天	-
	固化时间(150℃)	1h	-
	建议储存条件	@-5~-10 ℃ 6个月	-
固化后	硬度 shore D	85	GB/T 2411-2008
	介电强度 KV/mm	≥20	ASTM D149
	体积电阻率 Ω.cm	≥10 ¹⁴	GB/T 1410-2006
	剪切强度 MPa (Al/Al)	≥20	GB/T 7124-2008
	密度g/cm ³ @25℃	1.20±0.05	ASTM D 792
	耐温范围 ℃	-90 ~ 200	-

使用方法:

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 从冰箱取出后，在解冻时将注射器垂直放置；回温至25℃，开封前务必清除水汽。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染；解冻后的产品避免重新冻结。
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输:

- 塑料管包装，10cc、30cc、55cc、200cc支装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项:

- 对于高强度的结构粘接，去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 使用手套，尽量减少皮肤接触，不要用溶剂清洗双手；
- 为获得更大的粘接强度，推荐双面涂胶；
- 固化过程中采用适当夹具并且保证不要产生粘接部件之间的相对位移，固化前清楚多余的余胶；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。





国产化电子胶粘材料解决方案

